サンケン電気 ステッピングモータドライバ アダプタ
（SLA-CB18P、SLA-CB23P）

目 次

	ページ
1.概要	2
2.構成部品	2
3.対応製品名	3
4.基板外観	5
5.部品実装	6
6.注意事項	7

1.概要

サンケン電気のステッピングモータドライバ IC は高性能でラインナップも多く既製品のステッピングモータのドライバとして使用されることが多いですが、ピン配置がジグザグの ZIP 配列になっていてブレッドボードやユニバーサル基板へ取り付けることが出来ず個人として使うことが難しくなっています。

ブレッドボードやユニバーサル基板で簡単に使用できるように一般の IC と同じ 2.54mm(0.1 インチ)ピッチへの変換基板を作成しました。ドライバ IC が比較的高価なためユニバーサル基板上でも繰り返し使えるように、変換したピンは丸ピン IC ソケットに装着出来る細ピンタイプになっています。

2.構成部品

構成部品は下記の通りです。キット品を購入の際には部品の不足が無いか確認をお願いいたします。

表-1 構成部品リスト

【SLA-CB18P】(18 ピン対応品)

基板記号	名称	型番	個数	備考
-	基板	-	1	
-	連結ソケット(両端オスピン)	18 ピン	1	

【SLA-CB23P】(23 ピン対応品)

基板記号	名称	型番	個数	備考
-	基板	-	1	
-	連結ソケット(両端オスピン)	18 ピン	1	
-	連結ソケット(両端オスピン)	6 ピン	1	

3.対応製品名

サンケン電気のステッピングモータドライバ IC の中で需要が多いと考えられる 18 ピンと 23 ピンの IC に対応した変換基板を作成しました。対応する製品名は下記の通りです。

購入前にサンケン電気のカタログ等でピン配置の寸法が対応しているか自己責任で確認してください。

表-2 対応品番リスト

【SLA-CB18P】(18 ピン対応品)

励磁方式	出力電流[A]	モーター 電源電圧[V]	対応製品名	備考
2 相 1-2 相励磁	1.0	～46	SLA7027MU	
			SLA7031M	
			SLA7050M	シーケンサ内蔵
	1.5		SLA7024M	
			SLA7032M	
	2.0		SLA7051M	シーケンサ内蔵
	3.0		SLA7026M	
			SLA7033M	
			SLA7052M	シーケンサ内蔵
2W1-2 相励磁 μStep 対応	1.2		SLA7042M	
	3.0		SLA7044M	

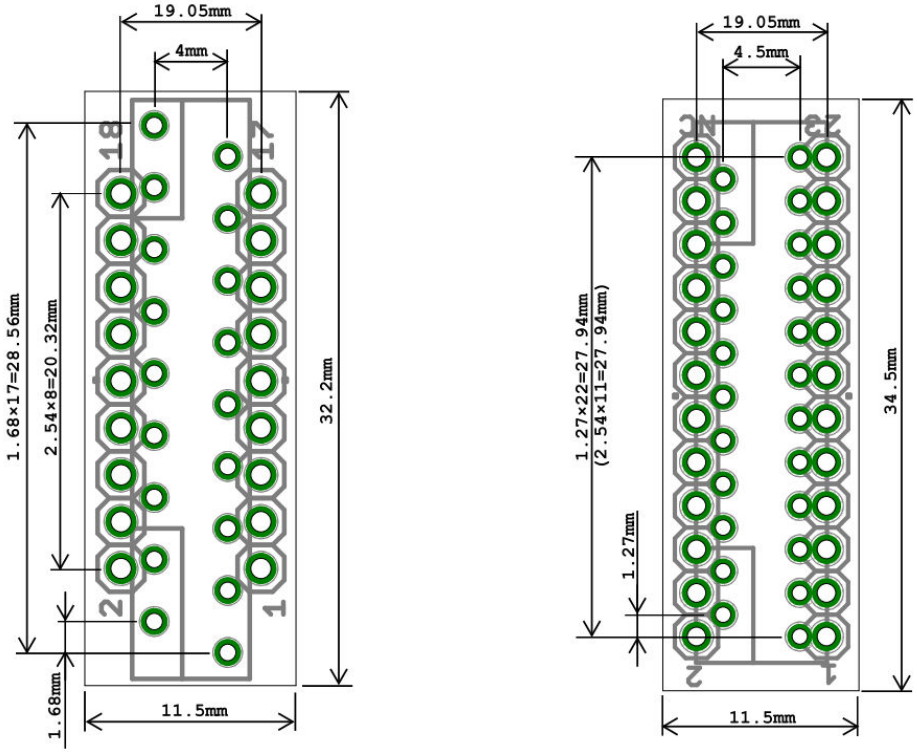
表-2 対応品番リスト(続き)

【SLA-CB23P】(23 ピン対応品)

励磁方式	出力電流[A]	モーター 電源電圧[V]	対応製品名	備考
2 相 1-2 相励磁	1.0	～46	SLA7070MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7070MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
			SLA7080MR	電流検出抵抗内蔵
			SLA7080MPR	電流検出抵抗内蔵、保護機能搭載
	1.5		SLA7071MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7071MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
			SLA7081MR	電流検出抵抗内蔵
			SLA7081MPR	電流検出抵抗内蔵、保護機能搭載
	2.0		SLA7072MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7072MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
			SLA7082MR	電流検出抵抗内蔵
			SLA7082MPR	電流検出抵抗内蔵、保護機能搭載
	3.0		SLA7073MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7073MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
			SLA7083MR	電流検出抵抗内蔵
			SLA7083MPR	電流検出抵抗内蔵、保護機能搭載
4W1-2 相励磁 μ Step 対応	1.0		SLA7075MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7075MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
	1.5		SLA7076MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7076MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
	2.0		SLA7077MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7077MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載
	3.0		SLA7078MR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵
			SLA7078MPR	シーケンサ、電流検出抵抗内蔵 保護機能搭載

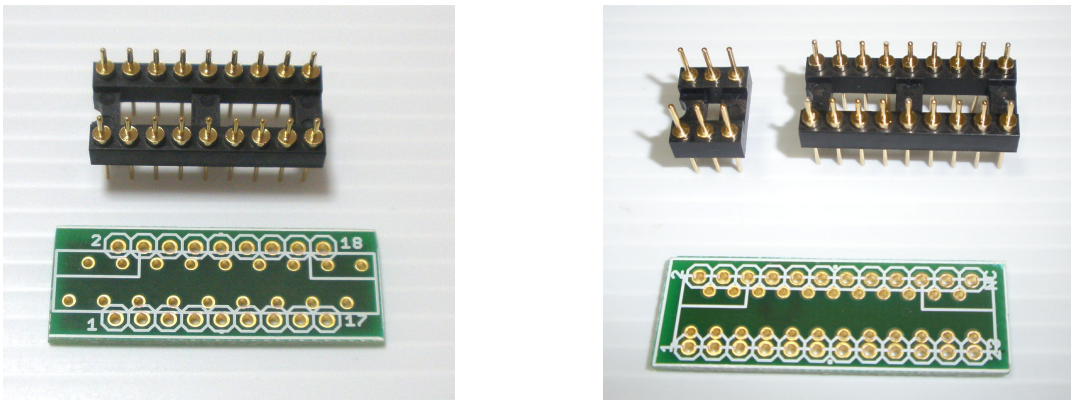
4.基板外観

基板外観は下記の通りです。



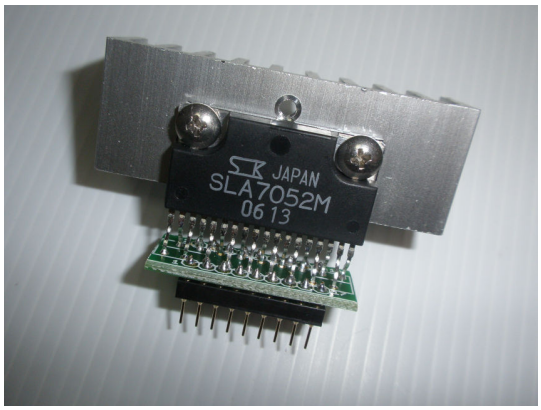
(a) SLA-CB18P　　(b) SLA-CB23P

図-1 基板外観

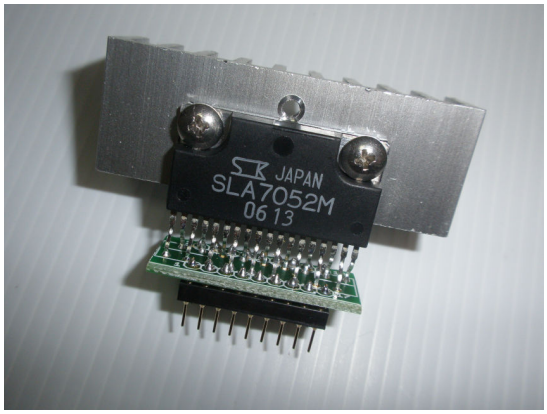


(a) SLA-CB18P　　(b) SLA-CB23P

図-2 商品写真



(a) SLA-CB18P



(b) SLA-CB23P

※ ドライバ IC とヒートシンクは別売になります。

図-3 完成品写真

5.部品実装

基板への部品実装前に連結ソケットの向きを確認してください。連結ソケットの足は太い方と細い方があり、通常の丸ピンに刺さるのは細い方のみです。図-4 を参考に向きを確認してください。

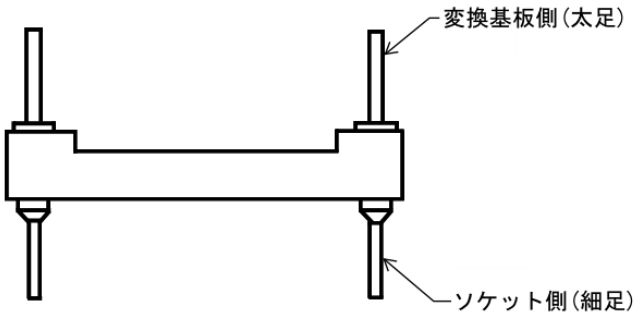


図-4 連結ソケットの向き

次にハンダ付けする前にドライバ IC と連結ソケットの仮組みしてください。ドライバ IC の足を深く装着すると連結ソケットに当たってしまうので仮組みして装着深さを確認してからハンダ付けすると確実です。また、ドライバ IC を先にハンダ付けしないと連結ソケットが邪魔でハンダ付け出来ませんのでご注意ください。

6.注意事項

使用する前に本取扱説明書をよく読み、御理解頂いた上で御使用ください。

受取時点での部品洩れや回路基板のキズ等による不良を除き、本回路を使用して生じた損害に対して一切責任を負いかねますので、あらかじめ御了承下さい。